

## Special Component Mounter

# SCM1

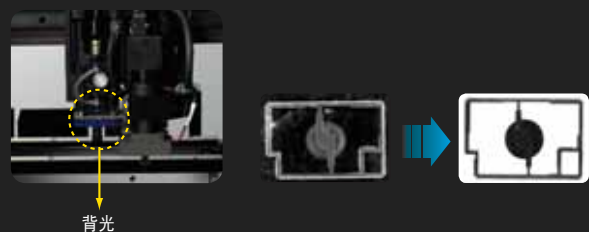
- ▶ 0.68m宽的超薄异型专用机
- ▶ 可以处理的异型元件范围达~□45mm(以带式喂料器为准)
- ▶ 增强了异型元件的处理能力
  - 背光(Back Light)识别
  - 屏蔽罩(Shield Can)装贴精度检查
- ▶ 允许混流生产(选项)
  - 同种PCB(顶/底)
- ▶ 允许电动式/气压式供料器混用
- ▶ 内置料带切刀(选项)



### 增强异型元件处理能力

#### ▶ 背光识别

贴片头内适用背光，改善了视觉识别率。



### 增强了屏蔽罩处理能力

#### ▶ 装贴精度检查功能

装贴了屏蔽罩后进行装贴精度检查，事先防止不良。



#### ▶ 适用了屏蔽罩元件专用识别算法

元件自动示教功能及屏蔽罩专用编辑画面等，可以提供多样化的识别算法。



### 允许电动式/气压式供料器混用

#### ▶ 电动式供料器与气压式供料器混用

可以根据工作人员的环境选择适当的喂料器。

#### ▶ Splicing单元自动跳过(Auto Skip)功能(选项: 电动式喂料器)

使用Splicing Detect专用Joint Tape时可以。



### 提高了操作便利性



## Special Component Mounter

# SCM1



### 规格

型号		SCM1 (单轨道)	SCM1 (双轨道)
识别方式		固定相机	固定相机
主轴数量		1主轴 x 1悬臂	1主轴 x 1悬臂 2主轴 x 1悬臂(选项)
贴装速度		2,400 CPH(本公司基准)	2,400 CPH(本公司基准) 3,000 CPH(2 Spindles 本公司基准)
装贴精度		± 50μm@μ+3 Sigma(1005 为准)	± 50μm@μ+3 Sigma(1005 为准)
元器件范围	固定相机(FOV 45)	1005 ~ 45mm(Lead Pitch 0.4mm)	1005 ~ 45mm(Lead Pitch 0.4mm)
	最大高度	H = 15mm	H = 15mm
电路板(Board)尺寸 (mm)	最小	50(L) x 50(W)	50(L) x 50(W)
	最大	250(L) x 250(W) 300(L) x 250(W)(选项)	250(L) x 250(W) 300(L) x 250(W)(选项)
	PCB厚度	0.38~4.2	0.38~4.2
供料器容量		16ea	32ea
能耗	电源	AC220 V(单相50/60Hz)	AC220 V(单相50/60Hz)
		最大2.0kVA	最大2.0kVA
	耗气量	0.5~0.7MPa(5.1~7.1kgf/cm <sup>2</sup> )	0.5~0.7MPa(5.1~7.1kgf/cm <sup>2</sup> )
150Nℓ/min		150Nℓ/min	
重量		约750kg	约750kg
外观尺寸(mm)		680(L) x 1,480(D) x 1,480(H)	680(L) x 1,870(D) x 1,480(H)



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Intelligent Machinery & Solution Division  
IMS事业部SMT营业组(Team)

- 上海总公司  
公司名称：上海三星机电设备贸易有限公司  
公司地址：中国上海市宜山路900号科技大楼A楼1101室  
电话：86-021-5423-5050 / 传真：86-021-5423-5122
- 深圳分公司  
公司名称：上海三星机电设备贸易有限公司深圳分公司  
公司地址：中国广东省深圳市南山区科技园南区中电照明中心北一楼A  
电话：86-755-2674-8338 / 传真：86-755-2674-8338 分机 8400
- <http://www.samsung-smt.co.kr>

※ 本公司为了提升产品品质而修改本型录上的规格时将不另行告知。



Nov. 2010\_C